

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于签署为星源电子申请综合授信提供担保相关合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意 2018 年度公司为全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）担保总额不超过 7 亿元。

公司为星源电子向中国银行深圳宝安支行、华夏银行深圳龙华支行申请银行综合授信签署了相关担保合同，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为支持全资子公司星源电子的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，经股东大会批准，公司为星源电子向银行申请 7 亿元的综合授信额度提供担保，担保总额合计不超过 7 亿元人民币。

二、担保协议的主要内容

1、公司与中国银行深圳宝安支行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：

（1）主合同：债权人中国银行深圳宝安支行与债务人星源电子之间签署的编号为 2018 圳中银宝额协字第 0000029 号的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充。

（2）被担保最高债权额

a、本合同所担保债权之最高本金余额为：1.6 亿元人民币。

b、在本合同所确定的主债权发生期间（2018 年 9 月 4 日-2019 年 9 月 3 日）

届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

（3）本次担保为连带责任担保。

2、公司与华夏银行深圳龙华支行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：

（1）本合同项下的主合同形式为：华夏银行深圳龙华支行与主合同债务人星源电子签订编号为 SZ30（融资）20180013 的《最高额融资合同》，该合同与其项下发生的具体业务合同共同构成本合同的主合同。

（2）本合同项下被担保的最高债权额为：人民币捌仟万元整。

该最高债权额指最高主债权之融资额度余额（以下简称“融资额度余额”），具有以下含义：

①主合同债务人在主合同项下任一时点使用中尚未清偿的融资额度余额不超过上述限额，但在上述限额内，主合同债务人对已清偿的融资额度可申请循环使用；

②最高债权额仅为主债权本金的最高限额，在本金不超过上述限额的前提下，由此而产生的本合同约定范围内的利息、罚息、费用等所有应付款项，公司均同意承担担保责任。

（3）本合同项下被担保的主债权的发生期间为 2018 年 11 月 22 日至 2019 年 11 月 22 日。

（4）本次担保为连带责任担保。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，本公司累计对外担保余额为 51,524 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.60%。

本公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一九年三月六日